# 技术创新需求调查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业信息** | | | | | | | | | | |
| 企业名称 | | | | 昆山玛冀电子有限公司 | | | 机构代码 | |  | |
| 区 域 | | | | 花桥 | 联系人 | 秦志伟 | | 电话 | | 18506159339 |
| 行业领域 | | | | 电感器 | | | 产业领域 | | 新材料 | |
| 经济规模 | | | | 无 | | | 人员规模 | | 无 | |
| **需求信息** | | | | | | | | | | |
| 需求名称 | | | 电感器及磁性材料的研究 | | | | | | | |
| 技术需求情况说明 | 技术需  求类别 | | ☑技术研发（关键、核心技术）  ☑产品研发（产品升级、新产品研发）  □技术改造（设备、研发生产条件）  □技术配套（技术、产品等配套合作） | | | | | | | |
| 技术  需求  简述 | |  | | | | | | | |
|  | 技术  需求  详述 | | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标）   1. 测试技术支持   需要高校或研究机构能够协助进行SEM测试、能谱分析、X-Ray测试、DSC测试、热重分析(TGA)、TMA测试等测试，并协助分析产品、胶材提出改善对策；   1. 电感器结构创新、设计开发； 2. 研发技术支持 3. 共同开发具有更优异性能的高分子粘接剂（固化温度180±10℃、粘结包覆效果好、Tg转变温度高）； 4. 共同开发包覆、绝缘效果更好的铁粉钝化材料（有机类及无机类）（包覆层厚度在1-2um，产品绝缘效果达到100V，1GΩ左右，钝化包覆层与环氧树脂亲和力好）； | | | | | | | |
| 现有  基础  情况 | | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等） | | | | | | | |
| 产学研合作要求 | 简要  描述 | | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求）   1. 希望高校或研究机构有完善的高分子、磁性材料测试分析仪器、设备，并有专门的高分子材料研究团队； 2. 希望研发团队有磁性材料钝化剂（无机类或有机类）成功开发经验； 3. 研发团队需要有丰富的粘接剂开发经验，能够提供粘接剂及固化剂使用、选配推荐及开发。 | | | | | | | |
| 合作  方式 | | □技术转让 □技术入股 □联合开发 □委托研发  □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 | | | | | | | |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融  □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购  □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 | | | | | | | | | |
| **管理信息** | | | | | | | | | | |
| 同意公开  需求信息 | | ☑是 □否  □部分公开(说明） | | | | | | | | |
| 同意接受  专家服务 | | □是  □否 | | | | | | | | |
| 同意参与对解决方案的筛选评价 | | □是  □否 | | | | | | | | |
| 同意对优秀解决方案给予奖励 | | □是，金额 万元。（奖金仅用作奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件）  □否  法人代表： 年 月 日 | | | | | | | | |

**※请务必确认“同意公开需求信息”一栏填“是”**